

## ESPRIMO™ E Green PC Small Formfaktor PC

Ausgabe April 2008

Seiten 7

Stellen Sie maximale Leistung auf Ihren Schreibtisch. ESPRIMO E Small Formfaktor PC, der sowohl vertikal als auch horizontal betrieben werden kann. Dank der reichhaltigen Auswahl an Technologie und dem langen Lebenszyklus von bis zu 18 Monaten ist der ESPRIMO E die beste Wahl für Kunden, die einen qualitativ hochwertigen Desktop benötigen.

ESPRIMO Professional PCs werden aus ausgewählten Materialien hergestellt, um die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren. Bereits bei der Produktentwicklung wird die Umweltverträglichkeit über den gesamten Produktlebenszyklus berücksichtigt und optimiert. ESPRIMO Professional PCs erfüllen neben den gesetzlichen Anforderungen viele weitergehende nationale und internationale Umweltstandards in den Bereichen der Produktentwicklung, Produktion, Gebrauch, Transport und Recycling.

Komfortables Arbeiten mit der ESPRIMO E Plattform: Ergonomisch, leise und zuverlässig. Die Administration ist einfach und sicher. Verschiedene Produktspezifikationen des ESPRIMO E erlauben die Integration in jede Büroarbeitsumgebung. Zusammengefasst: Diese höchst zuverlässige Plattform lässt sich spezifisch an Ihre Business Anforderungen anpassen.

### Zuverlässigkeit

- Erstklassige Fertigung. Ausgezeichnet mit dem Bayerischen Qualitätspreis
- Hohe Qualität und funktionelle Stabilität durch eigene Entwicklung und Fertigung
- Kurze Antwort- und Lieferzeiten
- Verschiedene Logistikkonzepte für zeitgerechte und maßgeschneiderte Lieferung: value4you, made4you
- Garantie, Services und Ersatzteilversorgung gemäß Ihren Bedürfnissen

### Manageability

- Umfangreiche Verwaltungsfunktionen auf Basis von DeskView Client Management
- DeskView Migrate, Control: Optionale Softwarepakete für optimale Integration der Systeme in Ihre IT Umgebung

### Security

- Zugangs- und Datenschutz mit ausgefeilten Hardware und Softwarekomponenten

### Kundenspezifische Fertigung

- Vollständig konfigurierbar: Prozessor, Arbeitsspeicher, Laufwerke, Zusatzkarten
- Individuelle Auswahl an Hardware, Software und Design

### Ergonomie

- Produkt- und Produktionskonzept für minimale Auswirkung auf die Umwelt
- Reduzierung von Ausfallzeiten durch servicefreundliches Gehäuse und einfachem Komponentenzugriff
- Stressfreies Arbeiten und leiser Betrieb dank niedriger Geräuschemission
- Blauer Engel - weil energiesparend und geräuscharm



[www.wwf.de/computer](http://www.wwf.de/computer)



	E5615, EPA	E5615	E5616	E5625	E5625 EPA	E5720	E5720, EPA	E5925 vPro™	E5925 vPro™, EPA
<b>Mainboard</b>									
Chipsatz	NVIDIA C51PV	NVIDIA C51PV	NVIDIA C51PV D2464-B	NVIDIA MCP78B	NVIDIA MCP78B	iQ33	iQ33	iQ35 vPro™	iQ35 vPro™
Mainboard Mainboard Formfaktor	D2464-A Proprietär	D2464-A Proprietär	D2464-B TPM Proprietär	D2724 Proprietär Sockel AM2+	D2724 Proprietär Sockel AM2+	D2594 Proprietär	D2594 Proprietär	D2598 Proprietär	D2598 Proprietär
Prozessorsockel	Sockel AM2	Sockel AM2	Sockel AM2	Sockel AM2+	Sockel AM2+	LGA 775 800/1066/ 1333 MHz	LGA 775 800/1066/ 1333 MHz	LGA 775 800/1066/ 1333 MHz	LGA 775 800/1066/ 1333 MHz
Front Side Bus / System Bus	2000 MHz Phoenix V 6.0	2000 MHz Phoenix V 6.0	2000 MHz Phoenix V 6.0	4000 MHz Phoenix V 6.0	4000 MHz Phoenix V 6.0	1333 MHz Phoenix V 6.0	1333 MHz Phoenix V 6.0	1333 MHz Phoenix V 6.0	1333 MHz Phoenix V 6.0
BIOS Flash EPROM BIOS Update per Software	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Recovery BIOS	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>Prozessor</b>									
Intel® Core™ 2 Quad Q9xxx L2 Cache	-	-	-	-	-	-	-	bis Q9450 (ca. 04/08) 6MB/12MB	bis Q9450 (ca. 04/08) 6MB/12MB
Front Side Bus (FSB)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intel® Core™2 Duo E8xxx L2 Cache	-	-	-	-	-	bis E8500 6 MB	bis E8500 6 MB	bis E8500 6 MB	bis E8500 6 MB
Front Side Bus (FSB)	-	-	-	-	-	1333 MHz	1333 MHz	1333 MHz	1333 MHz
Intel® Core™2 Duo E6xxx L2 Cache	-	-	-	-	-	bis E6850 4 MB	bis E6850 4 MB	bis E6850 4 MB	bis E6850 4 MB
Front Side Bus (FSB)	-	-	-	-	-	1333 MHz	1333 MHz	1333 MHz	1333 MHz
Intel® Core™2 Duo E4xxx L2 Cache	-	-	-	-	-	bis E4600 2 MB	bis E4600 2 MB	bis E4600 2 MB	bis E4600 2 MB
Front Side Bus (FSB)	-	-	-	-	-	800 MHz	800 MHz	800 MHz	800 MHz
Intel® Pentium™ Dual Core E2xxx L2 Cache	-	-	-	-	-	bis E2200 1 MB	bis E2200 1 MB	bis E2200 1 MB	bis E2200 1 MB
Front Side Bus (FSB)	-	-	-	-	-	800 MHz	800 MHz	800 MHz	800 MHz
Intel® Celeron L2 Cache	-	-	-	-	-	bis 440 512 KB	bis 440 512 KB	bis 440 512 KB	bis 440 512 KB
Front Side Bus (FSB)	-	-	-	-	-	800 MHz	800 MHz	800 MHz	800 MHz
Phenom™ Quad Core (Sockel), verfügbar ca. 05/2008	-	-	-	bis 9550 (AM2+)	-	-	-	-	-
L2 Cache	-	-	-	2 MB	-	-	-	-	-
L3 Cache	-	-	-	2 MB	-	-	-	-	-
System Bus Unterstützung	-	-	-	3600 MHz	-	-	-	-	-
Phenom™ Triple Core (Sockel), verfügbar ca. 05/2008	-	-	-	bis 8450 (AM2+)	-	-	-	-	-
L2 Cache	-	-	-	1,5 MB	-	-	-	-	-
L3 Cache	-	-	-	2 MB	-	-	-	-	-
System Bus Unterstützung	-	-	-	3200 MHz	-	-	-	-	-
Athlon™ 64 X2 Dual Core (Sockel)	-	-	-	bis 5600+ (AM2)	bis 5600+ (AM2)	-	-	-	-
L2 Cache	-	-	-	bis 2 MB	bis 2 MB	-	-	-	-
L3 Cache	-	-	-	-	-	-	-	-	-
System Bus Unterstützung	-	-	-	2000 MHz	2000 MHz	-	-	-	-
Athlon™ Dual Core (Sockel) Energieeffizient	-	-	-	4450e (AM2)	4450e (AM2)	-	-	-	-
L2 Cache	-	-	-	1MB	1MB	-	-	-	-
L3 Cache	-	-	-	-	-	-	-	-	-
System Bus Unterstützung	-	-	-	2000 MHz	2000 MHz	-	-	-	-
Athlon™ Single Core (Sockel) Energieeffizient	-	-	-	LE-1640 (AM2)	LE-1640 (AM2)	-	-	-	-
L2 Cache	-	-	-	512 MB	512 MB	-	-	-	-
L3 Cache	-	-	-	-	-	-	-	-	-
System Bus Unterstützung	-	-	-	2000 MHz	2000 MHz	-	-	-	-
Sempron™ Single Core (Sockel) Energieeffizient	-	-	-	LE-1250 (AM2)	LE-1250 (AM2)	-	-	-	-
L2 Cache	-	-	-	512 KB	512 KB	-	-	-	-
L3 Cache	-	-	-	-	-	-	-	-	-
System Bus Unterstützung	-	-	-	1600 MHz	1600 MHz	-	-	-	-
AMD Athlon™ 64 X2 (Sockel)	bis 5200+ (AM2)	bis 5200+ (AM2)	bis 5200+ (AM2)	-	-	-	-	-	-
L2 Cache	2x 512 KB	2x 512 KB	2x 512 KB	-	-	-	-	-	-
System Bus Unterstützung	2000 MHz	2000 MHz	2000 MHz	-	-	-	-	-	-
AMD Athlon™ 64 (Sockel)	3800+ (AM2)	3800+ (AM2)	3800+ (AM2)	-	-	-	-	-	-
L2 Cache	512 KB	512 KB	512 KB	-	-	-	-	-	-
System Bus Unterstützung	2000 MHz	2000 MHz	2000 MHz	-	-	-	-	-	-
AMD Sempron™ (Sockel)	3600+ (AM2)	3600+ (AM2)	3600+ (AM2)	-	-	-	-	-	-
L2 Cache	256 KB	256 KB	256 KB	-	-	-	-	-	-
System Bus Unterstützung	1600 MHz	1600 MHz	1600 MHz	-	-	-	-	-	-
AMD Athlon™ X2 (Sockel) Energieeffizient	BE-2350 (AM2)	BE-2350 (AM2)	BE-2350 (AM2)	-	-	-	-	-	-
L2 Cache	2x 512 KB	2x 512 KB	2x 512 KB	-	-	-	-	-	-
System Bus Unterstützung	2000 MHz	2000 MHz	2000 MHz	-	-	-	-	-	-







	E5615, EPA	E5615	E5616	E5625	E5625 EPA	E5720	E5720, EPA	E5925 vPro™	E5925 vPro™, EPA
<b>Kompatibilität (Referenzen)</b>									
Microsoft Betriebssysteme (HCT / HCL Eintrag)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
PC 2001, DMI 2.0, WMI 1.5, USB 2.0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>Manageability</b>									
ASF 2.0 (Alert Standard Format)	-	-	-	x	x	x	x	x	x
iAMT 2.x (Intel Active Management Technology). Nicht aktiviert oder provisioniert. Nur für Windows XP und Vista Business	-	-	-	-	-	-	-	x (v.3.0)	x (v. 3.0)
DeskView 10.x Client Management inklusive:									
On / Offline Remote Client Management	x	x	x	x	x	x	x	x	x
System Inventarisierung & Reporting	x	x	x	x	x	x	x	x	x
BIOS Management	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Remote Power Management	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Nachrichten der Systemüberwachung	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Umfangreiche Alarime (mit ASF)	-	-	-	-	-	x	x	x	x
Security Remote Control	x	x	x	x	x	x	x	x	x
DeskView Helpdesk Integration	x	x	x	x	x	x	x	x	x
DeskUpdate Treiber Management	x	x	x	x	x	x	x	x	x
DeskView Migrate	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional
DeskView Control	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional
PXE 2.1 Bootcode	x	x	x	x	x	x	x	x	x
BootP Bootcode inclusive									
BootManage Administrator SW	getestet	getestet	getestet	getestet	getestet	getestet	getestet	getestet	getestet
Wake up aus S5 Modus (Off)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Intrusion Detection Schalter	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional
<b>Sicherheit</b>									
<i>Sicherheitsfunktionen im Gehäuse</i>									
Vorbereitet für Kensingtonschloss, Öse für Vorhängeschloss, Verplombungsmöglichkeit	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Integriertes Gehäuseschloss	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional
<i>Systemsicherheit</i>									
Bootsektor Virenschutz	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Schreibschutzoption für Flash EPROM	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Embedded Security (TPM1.2)	-	-	Infineon	Infineon	Infineon	Infineon	Infineon	Infineon	Infineon
Kontrolle aller USB Schnittstellen / nur der externen USB Schnittstellen	x / -	x / -	x / -	x / x	x / x	x / x	x / x	x / x	x / x
Bootschutz für Floppy- / CD, Schreibschutz für Floppy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Kontrolle der externen Schnittstellen	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<i>Benutzersicherheit</i>									
Setup / System BIOS-Passwort	x	x	x	x	x	x	x	x	x
SystemLock 2 BIOS SmartCard Security	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Festplattenpasswort	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Zugriffsschutz durch externen Chipkartenleser	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional
Zugriffsschutz durch internen Chipkartenleser	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional
<b>Serviceability</b>									
FlexySlot	x	x	x	x	x	x	x	x	x
EasyFix	x	x	x	x	x	x	x	x	x
EasyChange (HDD / optische Laufwerke)	x / x	x / x	x / x	x / x	x / x	x / x	x / x	x / x	x / x
EasyPull	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>Verpackungsinformationen</b>									
Umverpackung (H x B x T) mm	500 x 290 x 540	500 x 290 x 540	500 x 290 x 540	500 x 290 x 540	500 x 290 x 540	500 x 290 x 540	500 x 290 x 540	500 x 290 x 540	500 x 290 x 540
Maximale Anzahl von Systemen pro Palette	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Material / Gewicht in Gramm									
Kartonage	1270	1270	1270	1270	1270	1270	1270	1270	1270
EPS / PS	230	230	230	230	230	230	230	230	230
PE	ca. 60	ca. 60	ca. 60	ca. 60	ca. 60	ca. 60	ca. 60	ca. 60	ca. 60
Benutzerdokumentation auf chlorfrei gebleichtem Papier									

**Recycling Informationen / Rücknahmeinformationen**

Vorstehende Produkte wurden für einfache Wiederverwertung entwickelt. Informationen bezüglich Rücknahme und Recycling finden Sie hier

<http://www.fujitsu-siemens.de/recycling>

**Informationen über unsere Umweltprogramme, Richtlinien und Ziele**

<http://www.fujitsu-siemens.de/aboutus>

**Materialhinweise**

Stoffverbotsliste gemäß Richtlinie (FSC 03230) „Umweltgerechte Produktgestaltung und -entwicklung“  
 Vorstehende Daten reflektieren Labormessungen. Kundenkonfigurationen können aufgrund anderer Software, Komponenten und Peripheriegeräten abweichen.

## Integriertes Umweltschutzkonzept über den gesamten Produktlebenszyklus

### Entwicklung

- Ökologische Konstruktionsrichtlinie:  
Basis unseres Umweltschutzkonzeptes ist die unternehmensweit verbindlich anzuwendende FSC Richtlinie (FSC 03230) „Umweltgerechte Produktgestaltung und –entwicklung. Diese definiert - über die gesetzlichen Vorgaben hinaus - ökologische Anforderungen über den gesamten Produktlebenszyklus, welche in der Designphase zu berücksichtigen sind. Somit werden bereits bis zu 80% der gesamten produkt-spezifischen Umweltauswirkungen optimiert.
- Integration von produktspezifischen Umweltchecks und -abnahmen in den Entwicklungsprozess

### Material

- Halogenfreie Kunststoff-Formteile und Gehäusekunststoffe
- Bleifreies Leiterplattenmaterial für Mainboard, Riser Karte und Stromversorgung (RoHS konform)
- Bleieintrag beim Mainboard lediglich durch nicht bleifrei verfügbare Komponenten (RoHS konform)
- Reduktion der Halogene für die Leiterplatten (Mainboard, Riser Karte, Stromversorgung): Verringerung der Chlor- und Bromanteile von ca. 12% - 15% auf unter 0,15 % gemäß dem globalen Standard JPCA-ES-OA-1999

### Produktion

- Eigene Mainboardfertigung mit modernster Löttechnologie
  - Bleifreie Lotpasten
  - Löten unter Stickstoff-Atmosphäre
  - Flussmittel auf wasserlöslicher Basis
- Geringer Wasserverbrauch
  - Kein Waschen der Mainboards nach dem Löten
  - Wasser-Kreislauf-Führung für die Reinigung der Produktionsmittel
- Vermeidung von Gefahrstoffen in der Produktion
  - Kein Reinigen der PC-Gehäuse vor dem Verpacken
  - Reduzierung der zu entsorgenden Abfälle
- Verpackungsvorschriften für Zulieferteile
- Produktion gemäß ISO14001 zertifiziert – der internationale Standard für Umweltmanagement

### Produktnutzung

- Besonders niedrige Geräuschentwicklung
  - Silent PC durch Lüfterregelung und Thermal Management
  - Silent PC per patentierter Lüftersteuerung
  - Geräuscharme Festplatten
  - Messung der Geräuschemission mit CD/DVD Betrieb
- Hohe Energieeffizienz
  - Energiesparen mit ACPI / IA-PC (Instantly available PC)
  - Separater Netzschalter (Aus-Schalter) in der Stromversorgung des ESPRIMO C
  - Stromversorgung mit geschaltetem Monitorausgang (ausgewählte Modelle)
- Langlebig und servicefreundlich
  - Öffnen des Gehäuses ohne Werkzeug
  - Viele Komponenten ohne Werkzeug zu entnehmen
  - Modulbauweise
  - Einfache Systemerweiterung

### Transport

- Chargenlieferungen, wieder verwendbare Transportverpackungen und recyclinggerechte Kartons helfen wertvolle Ressourcen zu sparen
- Großkundenverpackungen für Projekte (keine Einzelverpackungen)
- Weniger Transportvolumen durch Verpackungsoptimierung in der gesamten Inbound / Outbound-Logistik

### Recycling

- Hohe Recyclingfähigkeit der Produkte (> 90%)
- Leichte Demontage
- Alle Systeme werden bei Fujitsu Siemens Computers fachgerecht recycled:  
[www.fujitsu-siemens.de/wvm](http://www.fujitsu-siemens.de/wvm)

### Umweltauszeichnungen und –Kooperationen

- Kooperation mit dem WWF Deutschland:  
[www.wwf.de/computer](http://www.wwf.de/computer)
- Blauer Engel – RAL UZ78 konform  
[www.blauer-engel.de](http://www.blauer-engel.de)